

電子機器2025 トータルソリューション展 2025.6.4-6 東京ビッグサイト東展示棟

完全WEB登録制 事前登録 パッと登録! パッと入場!

www.jpccashow.com

事前会場登録のご案内

電子機器トータルソリューション展はWEB登録制となります。事前にWEBにて登録をお願いいたします。

STEP.1 公式ホームページより会場登録へお進みください。

STEP.2 ご登録いただいたメールアドレス宛に、パスワード設定のメールが届きます。24時間以内にパスワードの設定を完了してください。

STEP.3 展示会当日、来場者マイページより来場者バッジをプリントアウトし、四つ折りの状態でご持参ください。

公式HPはこちら



事前登録/最新情報はHPをご覧ください

開催概要

JPCA Show 2025 第54回 国際電子回路産業展

JIEP 2025 マイクロエレクトロニクス 第39回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2025 第26回 実装プロセステクノロジー展

AI Device Expo

WIRE Japan Show 2025

Electronics Component & Unit Show

E-Textile/Wearable

来場者参加型企画

ブースコンテスト

展示会オリエンテーション&ツアー

JPCA 賞表彰式

半導体 オブ・ザ・イヤー 2025 受賞製品・技術発表

アカデミックプラザ表彰式

電子機器トータルソリューション展 基調講演

6月4日(水) AIと半導体が世界経済を引っ張る主役の時代がやって来た!

6月5日(木) 日本の半導体政策について(仮)

6月6日(金) AFEELAにおけるモビリティの新たな価値基準の創造

JISSO PROTEC 特別講演

6月4日(水) スマートフォン・周辺機器、AIサーバーの業界見直し

6月5日(木) サイバートラック(テスラ)分解から読み解く電動商用パワー半導体実装技術トレンドと将来動向

6月6日(金) JEITA 2024 年度版実装技術ロードマップ

JIEP 最先端実装技術シンポジウム

Time	A 会場 (会議棟 605・606)	B 会場 (会議棟 607・608)
10:00-10:50	4A1-3 Beyond5Gに向けた高速・高周波用途向け基板材料の技術開発動向	4B1-1 2025年以降の電子機器と半導体市場トレンドを読む
10:50-11:40	4A1-2 5G/6Gに向けた低伝送損失基板材料の技術動向と評価技術	4B1-2 成長のための「新斬新マーケティング戦略」
11:40-12:30	4A1-3 5G/6Gに向けたBT/LSI積層材料の技術開発動向	4B1-3 新世代半導体パッケージ基板製造装置とプロセスのご紹介
13:30-14:20	4A2-1 光電融合技術の新潮流と最新動向	4B2-1 AIがもたらす半導体業界への影響
14:20-15:10	4A2-2 800Gbps/1.6Tbps 実現に向けた対応状況および技術動向	4B2-2 半導体産業の明るい未来
15:10-16:00	4A2-3 光xコンピューティングの研究動向	4B2-3 AI用半導体チップレットの最新動向
10:00-10:50	5A1-1 AI Hardwareの現状と課題	5B1-1 高機能化を実現する最先端実装技術の今
10:50-11:40	5A1-2 AIとコンピューティングの今とこれから	5B1-2 微細配線対応網めつきおよびエッチングプロセス
11:40-12:30	5A1-3 AI向けアクセラレータ開発と光インターコネク、現状と課題	5B1-3 メックの導体表面処理技術の開発ロードマップ紹介と、半導体向け選択エッチング技術の紹介(仮)
13:30-14:20	5A2-1 WBG/パワーデバイスの3D実装と通信・エッジコンピューティングの融合で広がるパワエレ・アプリケーション	5B2-1 最先端半導体に対応した最新のパッケージ基板技術
14:20-15:10	5A2-2 パワーモジュールの高放熱化技術開発動向(仮)	5B2-2 Glass Substrate for Heterogeneous Integration
15:10-16:00	5A2-3 パワ半導体GaNデバイスの社会実装を加速させるための取り組み	5B2-3 チップレット集積PSB(ピラーサスペンディッドブリッジ)を中心としたアドバンストパッケージングの半導体中工程技術について
10:00-10:50	6A1-1 半導体後工程の未来: チップレットパッケージング技術の革新	6B1-1 先端車載SOC用パッケージングの技術動向~チップレット適用に向けて~
10:50-11:40	6A1-2 Customization & Energy-efficiency Improvement with Advanced Packaging for AI Infra	6B1-2 カーボンニュートラルに向けた電動化とパワーエレクトロニクス
11:40-12:30	6A1-3 TSMCの3DIC技術と日本のエコシステムとの融合で世界のイノベーションを生み出す	6B1-3 自動車電動化および自動運転に対応した樹脂材料
13:30-14:20	6A2-1 CMP進化論: CMP for MM, MtM & BC (仮)	6B2-1 ウェアラブルデバイスに応用する伸縮FPC (Stretchable FPC) 技術
14:20-15:10	6A2-2 モールディングの変遷と先端パッケージングにおけるモールドング技術(仮)	6B2-2 印刷法を用いたストレッチャブル・立体多層配線形成技術とその応用
15:10-16:00	6A2-3 ハイブリッド接合の業界/学会の最新動向、課題と期待について	6B2-3 アクアプラズマを用いたウルトラフレキシブルデバイスの実装技術と応用例

PROTEC セミナー

6月4日(水) SDGsに関係するディスペンサ技術と液体材料について

6月5日(木) Autonomous Factoryの実現へ ~NPM-Gシリーズの新製品と進化~

6月6日(金) 【ものづくりの現場はどう変わる? オンデマンドAIと実装技術の最新情報】

ぶりんとばんじゅくセミナー

6月4日(水) プリント配線板全般の基礎「ぶりんとばんじゅくI」をもとに解説

6月6日(金) 実装の基礎「ぶりんとばんじゅくV」をもとに解説

主催者企画セミナー

6月4日(水)~6日(金) 疲労ストレス計MF100による自律神経状態の見える化とその活用例

6月5日(木) いのちをまもる@ほっさい 脳内訓練(仮)

6月4日(水) 経済安全保障セミナー

JEITA セミナー

6月5日(木) JEITA チップレット関連セミナー

ダントツものづくりセミナー

6月4日(水) 生産性向上ものづくりDX 特別セッション

6月5日(木) トヨタ式現場管理と改善取組・成果セッション

6月6日(金) TOC/管理会計セッション

JIEP アカデミックプラザ

6月4日(水) 人体通信技術を用いたドローン型型守りシステムの検討

6月5日(木) 樹脂バインダ中のスズ系フィラーの焼結現象の解析と導電性接着剤への応用

6月6日(金) 動力学シミュレーションを用いた多脚型マイクロロボットの歩容解析

デモンストレーション/体験

脳波ゲーム体験

疲労・ストレスの計測

東7ホール内特設会場

左右ボールねじカウンタバランス制御機構を有する穴あけ工作機械の加工率および品質を考慮したステップ動作の検討

左右ボールねじカウンタバランス制御機構を有する穴あけ工作機械の加工率および品質を考慮したステップ動作の検討

Table with 4 columns: Time, Seminar Title, Speaker/Company, and Venue. Rows include topics like EMI対策基板設計, ガラス・フィルム用レーザ加工システム, and プラズマ処理をえる! マイルドプラズマ.

スポンサー企業一覧

MEIKO and V-TECHNOLOGY logos and branding.

Logos for various sponsors including Dynatron, MNEC, 太陽インキ製造, PCBWay, mks, AIKO, MacDermid Alpha, VIEWWORKS, KYOSHA, SCREEN, SAKATA INX, ePARTS Electronics, NIKKEN, JFE, ISHIIHYOKI, and TOA MUSENKENKI.

出展者一覧

Main exhibitor list table with columns for company name, booth number, and contact information. Includes IPCA Show, JICA, and various electronics manufacturers.

Table with 2 columns: Time and Seminar Title. Topics include MIDの概要と日本MID協会の活動紹介, フェムト秒レーザを用いた回路形成技術, and JEITA・日本MID協会の実装用MIDテクニカルレポート.

Electronics Component & Unit Show 出展者プレゼンテーション 無料 事前登録不要 セミナー会場F

Table with 2 columns: Time and Seminar Title. Topic: "在庫処分"から"在庫活用"へ! 新しい在庫マネジメントの提案.

Table with 2 columns: Time and Seminar Title. Topics include MIDの概要と日本MID協会の活動紹介, 3D-MID&次世代先端半導体パッケージ設計環境のご紹介, and WFCが実現するこれまでもちがうMID工法.

展示ホール内ゾーニング

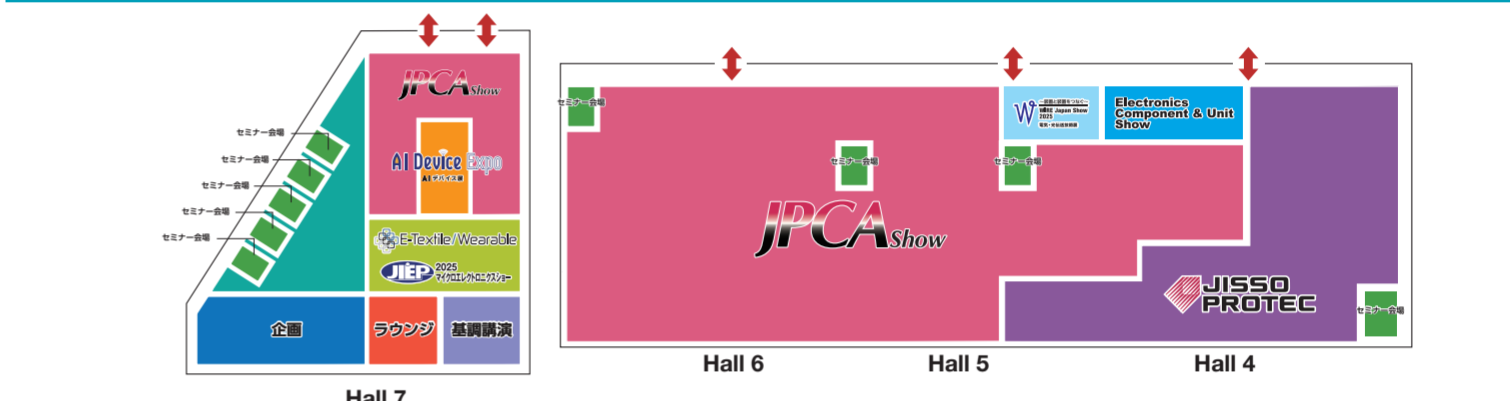


Table with 2 columns: Time and Seminar Title. Topics include 6月5日(木) 知って得する営業向けセミナー and 6月5日(木) 購入側から見たプリント配線板メーカーの選定方法.

PWBコンサルタントスキルアップセミナー 無料 事前登録 不要 セミナー会場L

Table with 2 columns: Time and Seminar Title. Topics include 6月4日(水) 陸上自衛隊化学学校の研究におけるE-スマートテキスタイルの活用 and 6月5日(木) 6月6日(金) 15:00~16:45.

E-Textile/Wearable展 基調講演 無料 事前登録 不要 セミナー会場I

Table with 2 columns: Time and Seminar Title. Topics include 6月4日(水) 陸上自衛隊化学学校の研究におけるE-スマートテキスタイルの活用 and 6月5日(木) 6月6日(金) 15:15-16:05.

E-Textile/Wearable展セミナー 無料 事前登録 不要 セミナー会場I

Table with 2 columns: Time and Seminar Title. Topics include 6月4日(水) 快適と感動を創る! : スマートテキスタイルの力 (仮) and 6月5日(木) 6月6日(金) 10:00-12:00.

Table with 2 columns: Time and Seminar Title. Topic: 快適と感動を創る! : スマートテキスタイルの力 (仮).

AI Device Expo and WIRE Japan Show logos and branding.

2025年4月9日(水)現在 (展示会別・50音順・法人格省略)

Table listing exhibitors by industry category: 電気通信大学, 電磁材料研究所, 東京工芸大学, etc.

*本招待状に掲載のプログラム他は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。講演当日は早めの受付にご協力お願いいたします。